

中国挠性覆铜板FCCL行业市场发展分析及前景趋势与投资研究报告(2026-2031版)

报告简介

根据所使用绝缘基材的不同，挠性覆铜板可分为聚酯基膜型(PET薄膜)、聚酰亚胺基膜型(PI薄膜)、液晶聚合物基膜型、玻纤布基环氧型、有机纤维无纺布基环氧型等种类。目前，使用得最广泛的是聚酯薄膜(PET薄膜)和聚酰亚胺薄膜(PI薄膜)。

根据统计数据，2019-

2021年特殊基板(封装基板及高频/高速板)产值年均复合增速8%，复合基板产值年均复合增速10%，其他类型覆铜板产值年均复合增速略有下滑。特殊覆铜板主要是高频/高速板和封装基板，具体包括BT/环氧玻璃纤维布板、改性FR-

4(低CTE和低Dk/Df)、PPO改性环氧板、类BT板、PTFE板、PI/玻璃纤维布板，应用于IC载板、高速数字、射频无线(RFwireless)、太空、测试等领域。

未来几年在5G、汽车自动驾驶、物联网等行业带动下，高频/高速等特殊基板市场需求将迅速扩大，发展前景良好。当前特殊覆铜板为海外企业所垄断，该领域主要生产厂家包括三菱瓦斯、日立化成、罗杰斯、Isola、Nelco、松下电工、斗山电子、Taconic、南亚塑胶等。近年，国内覆铜板企业生益科技、中英科技、泰州旺灵、华正新材等在高频/高速材料领域获得较大突破，部分产品可与Rogers(主打高频)、松下(主打高速)等同类产品媲美，未来在行业需求向上的背景下，进口替代空间巨大。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国挠性覆铜板FCCL市场进行了分析研究。报告在总结中国挠性覆铜板FCCL发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国挠性覆铜板FCCL的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为挠性覆铜板FCCL企业在激烈的市场竞争中洞察先机，

能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求

第一节 按不同基材分类的fccl品种

第二节 按不同构成分类的fccl品种

第三节 按不同应用领域分类的fccl品种

第四节 fccl品种的其它分类

第五节 产品主要采用的标准及性能要求

一、fccl管理体制

二、fccl相关标准

三、fccl的主要性能要求

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

第一节 三层型fccl的制造工艺法及其特点

一、片状制造法

二、卷状制造法

第二节 二层型fccl的制造工艺法及其特点

一、涂布法

二、溅射电镀法

三、层压法

四、三种工艺法生产的2l-fccl在性能、工艺特点方面的比较

第三节 近年fpc的技术发展方面

一、二层型fccl已成品种发展的主流

二、fccl近年在技术方面的进步

第三章 2021-2026年世界挠性覆铜板市场现状分析

第一节 2021-2026年世界挠性覆铜板产业发展概述

一、世界挠性覆铜板产业发展概述

二、世界fccl市场规模及结构

三、世界挠性覆铜板价格竞争分析

四、fccl原材料形态结构发生变化

第二节 2021-2026年世界挠性覆铜板区域市场分析

一、美国

二、日本

三、欧洲

四、韩国

五、中国台湾

第三节 2026-2031年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章 2021-2026年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析

第一节 新日铁化学株式会社

一、公司基本概况

二、2021-2026年公司经营与销售情况

三、2021-2026年公司竞争优势分析

第二节 宇部兴产株式会社

一、公司基本概况

二、2021-2026年公司经营与销售情况

三、2021-2026年公司竞争优势分析

第三节 台湾律胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第四节 新扬科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售分析

三、2021-2026年公司竞争优势分析

第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、2021-2026年公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第六节 旗胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第七节 东丽世韩有限公司

一、公司发展基本概况

二、公司经营策略分析

第八节 sd电线有限公司

第五章 2021-2026年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

第一节 2021-2026年中国覆铜板产业发展总体概述

- 一、中国覆铜板主要产品概述
- 二、中国覆铜板生产发展历程
- 三、中国覆铜板生产发展现状
- 四、中国覆铜板全面调研
- 五、中国覆铜板技改科研成果

第二节 2021-2026年中国挠性覆铜板产业发概况

- 一、中国挠性覆铜板产业发概况
- 二、中国挠性覆铜板生产情况分析
- 三、中国挠性覆铜板的产能与产量
- 四、中国挠性覆铜板企业销售状况

第三节 2021-2026年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章 2021-2026年中国挠性覆铜板相关市场调查

第一节 2021-2026年中国挠性印制电路业发展分析

- 一、柔性电路板相关概述
- 二、世界fpc产值及生产企业
- 三、我国fpc生产企业的现状
- 四、fpc多层挠性板的新技术
- 五、重庆彭水建柔性线路板基地

第二节 二层型挠性覆铜板在lcd的ic驱动用cof市场现状与发展

- 一、驱动ic用cof

二、驱动ic用cof挠性基板的性能特点及市场发展

三、cof挠性基板生产现状

第七章 2021-2026年中国印制电路板制造行业经济运行状况

第一节 2021-2026年中国印制电路板制造行业分析

第二节 2021-2026年中国印制电路板制造行业总体规模分析

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业企业规模分析

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业人员规模统计

三、2021-2026年中国印制电路板制造行业资产规模分析

四、2021-2026年中国印制电路板制造行业负债规模分析

五、2021-2026年中国印制电路板制造行业市场规模分析

第三节 2021-2026年中国印制电路板制造行业供需平衡分析

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业产成品分析

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业供给区域分布

三、2021-2026年中国印制电路板制造行业销售产值分析

四、2021-2026年中国印制电路板制造行业需求区域分布

第四节 2021-2026年中国印制电路板制造行业投资状况分析

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业投资增长分析

二、2021-2026年中国印制电路板制造行业投资区域分布

三、2021-2026年不同规模印制电路板制造企业资产总额分析

第五节 2021-2026年中国印制电路板制造行业获利能力分析

一、2021-2026年中国印制电路板制造行业利润总额分析

二、2021-2026年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析

三、2021-2026年中国主要省区印制电路板制造行业获利能力

第六节 2021-2026年中国印制电路板制造行业经营效益分析

一、2021-2026年印制电路板制造行业偿债能力分析

二、2021-2026年印制电路板制造行业盈利能力分析

三、2021-2026年印制电路板制造行业运营能力分析

四、2021-2026年印制电路板制造行业成长能力分析

第七节 2021-2026年中国印制电路板制造行业成本费用分析

一、2021-2026年印制电路板制造行业销售成本分析

二、2021-2026年印制电路板制造行业销售费用分析

三、2021-2026年印制电路板制造行业管理费用分析

四、2021-2026年印制电路板制造行业财务费用分析

第八节 2021-2026年中国印制电路板制造行业总体结构特征分析

一、2021-2026年印制电路板制造行业经济类型结构

二、2021-2026年印制电路板制造企业规模结构分析

三、2021-2026年印制电路板制造行业区域结构特征

第九节 2021-2026年中国印制电路板制造行业集中度分析

一、行业资产集中度分析

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

第八章 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口数据监测分析

第一节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口数据分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口数量情况

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口金额情况

第二节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口数据分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口数量情况

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口金额情况

第三节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口国家及地区分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析

第四节 2021-2026年中国覆铜板及铜箔进出口省市分析

一、2021-2026年中国覆铜板及铜箔进口省市情况

二、2021-2026年中国覆铜板及铜箔出口省市情况

第九章 2021-2026年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

第一节 广东生益科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第二节 金宝电子(中国)有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第三节 金安国纪科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第四节 广东超华科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第六节 无锡宏仁电子材料科技有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第七节 广东汕头超声电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第八节 胜宏科技(惠州)有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第九节 诺德投资股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第十节 广东嘉元科技股份有限公司

- 一、公司基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业产品概述
- 四、企业发展优势
- 五、企业发展战略

第十章 2021-2026年中国印刷电路板市场运行分析

第一节 2021-2026年中国印刷电路板行业发展概况

- 一、印刷电路板(pcb)分类及产业链
- 二、中国印刷电路板产量居世界首位
- 三、国内印刷线路板企业区域分布情况
- 四、印刷电路板技术发展水平及趋势
- 五、台湾柔性pcb公司在华东形成产业集群
- 六、重庆打造高技术印刷电路板产业高地

第二节 2021-2026年中国印刷电路板市场发展分析

- 一、2021-2026年中国印刷电路板产值规模
- 二、2021-2026年中国印刷电路板产品结构
- 三、中国印刷线路板市场集中度分析
- 四、中国印刷电路板市场需求特点分析

第三节 2021-2026年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

- 一、国内pcb配套产业还需进一步完善
- 二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱
- 三、企业基础技术研究与开发水平薄弱

四、行业无序竞争产品定价能力有限

五、pcb企业环保投入需进一步加强

第四节 2021-2026年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--pi薄膜

一、绝缘基膜的生产方式

二、fccl发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求

三、世界fccl用pi薄膜在品种和性能上的发展

四、世界挠性覆铜板用pi薄膜的市场需求情况

第二节 挠性覆铜板用导电材料

一、各类铜箔的品种及特征

二、压延铜箔

三、电解铜箔

四、fccl发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

一、fpc用胶粘剂发展概述

二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况

三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况

四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况

五、世界fpc及fccl用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章 中国挠性覆铜板用主要应用领域分析

第一节 航空航天

一、航空航天现状

二、挠性覆铜板在航空航天应用分析

三、挠性覆铜板在航空航天应用趋势

第二节 电脑

一、电脑现状

二、挠性覆铜板在电脑应用分析

三、挠性覆铜板在电脑应用趋势

第三节 汽车

一、汽车现状

二、挠性覆铜板在汽车应用分析

三、挠性覆铜板在汽车应用趋势

第四节 其他

第十三章 2026-2031年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

一、印刷电路板行业预测分析

二、对未来fpc技术发展预测

三、fpc发展对fccl提出更高性能的要求

第二节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

一、覆铜板生产供给预测分析

二、挠性覆铜板供给预测分析

第三节 2026-2031年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

附录

“十四五”发展规划

图表目录

图表：挠性聚酰亚胺覆铜板产品性能要求

图表：挠性聚酯覆铜板产品性能要求

图表：二层挠性覆铜板三种生产工艺对比情况

图表：2021-2026年全球挠性覆铜板销售额情况

图表：2021-2026年新日铁化学株式会社公司经营

图表：2021-2026年新日铁化学株式会社公司经营

图表：2021-2026年台湾律胜科技股份有限公司经营

图表：2021-2026年新扬科技股份有限公司经营

图表：亚洲电材股份有限公司

图表：中国大陆覆铜板产能区域分布情况

图表：按损耗因子分类的pcb材料

图表：中国覆铜板技改科研成果情况

图表：2021-2026年我国挠性覆铜板产量情况

图表：2021-2026年我国挠性覆铜板行业销售额情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板企业数量情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业从业人员数量情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业资产规模分析

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业负债规模情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业市场规模情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业销售收入分析

图表：国内印刷电路板需求区域分布情况

图表：近年pcb行业部分并购案例情况

图表：pcb项目投资地分布情况

图表：2021-2026年中国印刷电路板行业利润总额

图表：2021-2026年我国覆铜板进口金额变化情况

图表：2021-2026年我国覆铜板出口量变化情况

图表：2021-2026年我国覆铜板出口金额变化情况

图表：2021-2026年广东生益科技股份有限公司营业收入(单位：元)

图表：2021-2026年金安国纪科技股份有限公司营收分析(单位：元)

图表：2021-2026年广东超华科技股份有限公司营收情况

图表：企业产品介绍

图表：山东金宝电子股份有限公司部分产品示意图

图表：山东金宝电子股份有限公司部分产品示意图

图表：山东金宝电子股份有限公司部分产品示意图

图表：无锡宏仁电子材料科技有限公司研究人员

图表：2021-2026年广东汕头超声电子股份有限公司营收情况(单位：元)

图表：2021-2026年胜宏科技(惠州)有限公司营收情况

图表：2021-2026年诺德投资股份有限公司营收情况(单位：元)

图表：2021-2026年企业经营情况(单位：元)

图表：2021-2026年挠性覆铜板在航空航天应用

图表：2021-2026年我国挠性覆铜板在电脑应用规模

图表：2021-2026年挠性覆铜板在汽车应用市场规模

图表：“十四五”大型清洁能源基地布局示意图

图表：城镇化空间格局示意图

图表：京津冀地区轨道交通规划图

图表：粤港澳大湾区轨道交通规划图

图表：长三角地区轨道交通规划图

图表：重要生态系统保护和修复重大工程布局示意图

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：290116

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20220901/290116.shtml>

在线订购：[点击这里](#)